

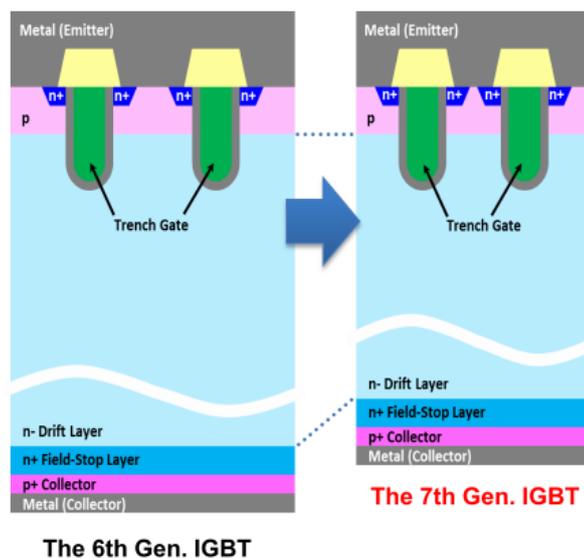
IGBT Technologien

IGBTs der 7. Generation: Downsizing, Verlustminimierung, Zuverlässigkeit

Alexander Theisen

Fuji Electric
Offenbach am Main

Erhöhung der Energieeffizienz bei gleichzeitigem Downsizing sind die Hauptanforderungen an moderne leistungselektronische Energiewandler. Die Steigerung der Zuverlässigkeit bei höherer Junction-Temperatur ist dabei die größte Herausforderung. Durch Verbesserung der Chipeigenschaften und die Entwicklung neuer Packagematerialien und -technologien, kann die maximale Betriebstemperatur auf bis zu 175°C erhöht werden.



Wann: Dienstag, 17.10.2017, 17:00 Uhr

Wo: S3 | 06/051 (Hans-Busch-Institut), Merckstraße 25

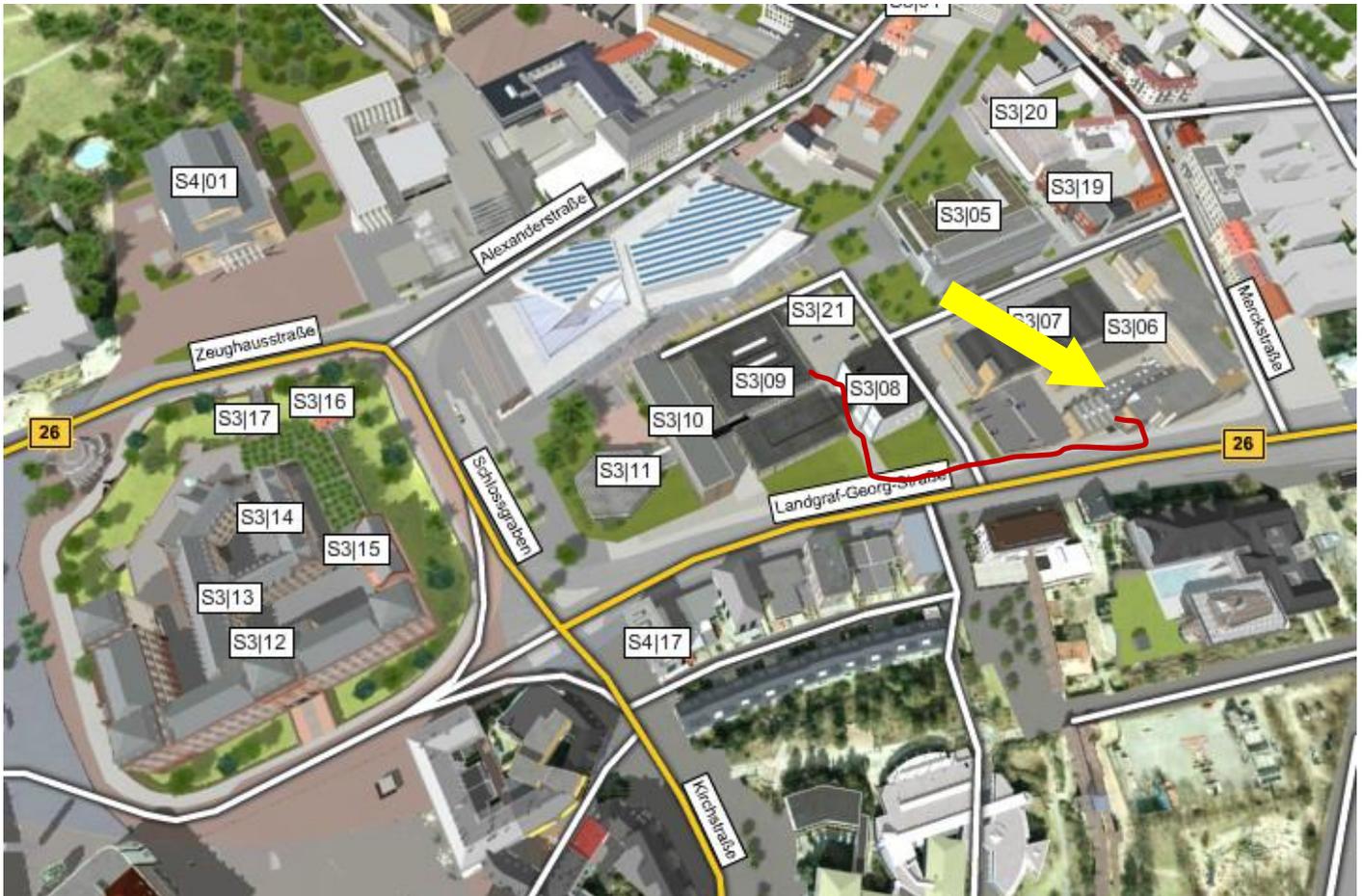
und anschließend...

...Leistungselektronisches Herbstfest mit Federweiser und Zwiebelkuchen
im Labor der SRT (S3|09/8)

Alle Interessenten sind herzlich eingeladen!



Lageplan S3|06 (Vorträge, HBI) Merckstraße 25



Lageplan Labor des SRT S3|09/8

